

第15回 未来科学オープンセミナー
未来イメージセンサと半導体集積回路の世界
-製造技術開発・回路設計・測定評価まで-

未来科学オープンセミナーでは、東北大学未来科学技術共同研究センターで行っている研究成果や独創的な開発研究を、オンライン配信によって分かりやすくご紹介いたします。

第15回は、黒田理人教授による、未来イメージセンサと半導体集積回路に関する最近の研究について紹介します。

【プログラム】

15:15 webサイトオープン

15:30 配信開始、イベント趣旨、注意事項説明

15:35 講演

未来科学技術共同研究センター
教授 黒田 理人

講演題目

未来イメージセンサと半導体集積回路の世界
-製造技術開発・回路設計・測定評価まで-
(講演の合間と終了後に質疑応答)

17:00 終了

黒田教授の研究と講演の内容

本セミナーでは、半導体集積回路やイメージセンサについて、製造技術、回路設計、測定評価などについて紹介します。人間の眼には見えない、広光波長帯域、高速度、ダイナミックレンジ性能を有するイメージセンサおよびその基盤技術と、非侵襲・非破壊センシングといった先進的な応用技術を解説します。また、イメージセンサ技術を応用展開して開発した、集積回路に実装された100万個のトランジスタ等の素子を高速に測定する測定・解析技術や今後の展開についても紹介します。

開催：令和4年 10月5日(水)

時間：15:30～17:00

開催方式：Zoomによるオンラインによる配信を予定

申込方法：裏面のE-mailまたはwebによる申し込み方法をご覧ください

主催：東北大学 未来科学技術共同研究センター(NICHe)

協賛：日本工学アカデミー東北支部・北海道支部

参加
無料

東北大学未来科学技術共同研究センターは、産学連携を通して、新しい技術の開発と、その実用化を目指して活動しています。

未来科学オープンセミナー 申し込み方法

1. E-mailによる申し込み

参加ご希望の方は下記の情報をご記入の上、下記宛先までE-mailでお申込ください。

- ・団体名（会社名・学校名）
- ・御所属・学年
- ・御氏名
- ・Eメールアドレス
- ・その他連絡事項

（同じ御所属より複数名ご参加の場合は、上記情報を参加される全員分をお書き下さい。）

E-mail

mirai@niche.tohoku.ac.jp

申込先

東北大学未来科学技術共同研究センター
未来科学オープンセミナー 事務局 宛

2. webからの申し込み

参加ご希望の方は下記ページのフォームに入力してお申込ください。

アドレス

<https://www.niche.tohoku.ac.jp/opseminar.html>

お申込みいただいた方に、後日連絡用E-mailアドレスに
10月4日(講演前日)にご参加方法をご送信いたします

※質疑応答につきまして
当日の質疑応答は、配信ソフトのチャット機能にお書込み、または
事前に事務局までメールをご送信ください。

〔締切〕 10月4日(火)正午